

ELETRONICA OGGI



Rivista Ufficiale di
Official Magazine of **dixet**

Distretto dell'Elettronica
e delle Tecnologie Avanzate

Tiratura | Print-run 7.900

Diffusione | Circulation 7.620

Mensile 9 numeri
(numero unico: Gennaio/febbraio
Luglio/agosto Novembre/dicembre)
Monthly 9 issues
(January/February July/August
November/December: combined
issue)

Data pubblicazione | Issue date
1^a settimana del mese
First week of each month

Tipo di stampa | Printing process
Offset piana / Web offset

• ELETTRONICA OGGI offre una visione a 360° del mondo delle tecnologie elettroniche. La rivista fornisce a ingegneri, manager tecnici e progettisti informazioni tempestive e approfondite che interessano tutti i settori dell'elettronica professionale – microprocessori, IC analogici e digitali, logiche programmabili, potenza, interconnessioni e packaging, strumentazione T&M e software EDA. ELETTRONICA OGGI è distribuita in abbonamento e con mailing list a una lista di distribuzione aggiornata e qualificata.
www.elettronicaoggi.it

• EO-WEB l'edizione online di ELETTRONICA OGGI, è il complemento indispensabile dell'edizione cartacea. News di prodotto, white paper, note applicative, idee di progetto, interviste esclusive sulle evoluzioni delle più recenti tecnologie rappresentano una risorsa informativa preziosa in ogni fase del ciclo di design, dall'idea alla produzione.
www.eo-web.it

• ELETTRONICA OGGI offers a global view of the electronic technologies world. The magazine provides engineers, technical managers and designers with well-timed and deep information concerning all professional electronic areas – microprocessor, analogic and digital ICs, programmable logic devices, power, interconnections and packaging, T&M instrumentation and EDA software. ELETTRONICA OGGI is distributed upon subscription through an updated and qualified list.
www.elettronicaoggi.it

• EO-WEB, the ELETTRONICA OGGI online edition, is the indispensable complement of the paper edition. Product news, white papers, application notes, design ideas, exclusive interviews concerning most recent technologies evolutions are a precious source in every cycle step, from idea to manufacturing.
www.eo-web.it

FORMATO	FORMAT	EURO 4/C
1/4 PAGINA	1/4 PAGE	900
1/3 PAGINA	1/3 PAGE	1.100
1/2 PAGINA	1/2 PAGE	2.000
2/3 PAGINA	2/3 PAGE	2.300
PAGINA	PAGE	2.800
MASTER	MASTER	9.000
I ROMANA	THIRD PAGE	3.300
COPERTINA	COVER	11.000
II COPERTINA	INSIDE FRONT COVER	3.500
III COPERTINA	INSIDE BACK COVER	2.900
IV COPERTINA	BACK COVER	5.100
BATTENTE COP.	COVER LEAF	6.600
INSERTO 2 FACCIATE	INSERT 2 FRONT	3.000
INSERTO 4 FACCIATE	INSERT 4 FRONT	5.000

LISTINO/PRICE LIST

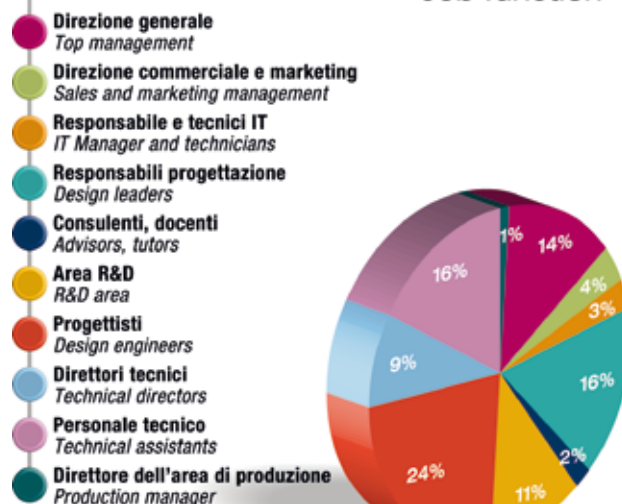
Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date

Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

Settori di interesse Fields of interest



Funzione aziendale Job function



MESE (ISSUE)	SPECIALE (DOSSIER)	AGGIORNAMENTI/ APPROFONDIMENTI (UPDATE/IN DEPTH)	ARTICOLI GENERALI (GENERAL ISSUES)	FIERE (EXHIBITIONS)
415 Gennaio/febbraio <i>January/February</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● IC multimediali (<i>Multimedia ICs</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● CPU in FPGA (<i>CPUs in FPGAs</i>) ● Smart Metering (<i>Smart metering</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● IC analogici/mixed signal (<i>Analog/mixed signal ICs</i>) ● Oltre la tecnologia CMOS (<i>Beyond CMOS</i>) ● Strumentazione T&M (<i>T&M instruments</i>) ● Tecnologie di memoria (<i>Memory technologies</i>) ● Architetture programmabili (<i>Programmable architectures</i>) 	<p>Opti 2012, 13-15/01 - Monaco (D) NI Days, 07/02 - Parigi (F) EMV 2012, 07-09/02 - Düsseldorf (D)</p>
416 Marzo <i>March</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Strumentazione basata su PC (<i>PC-based instruments</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Semiconduttori ed efficienza energetica (<i>Semiconductors and energy efficiency</i>) ● Nuove architetture di microprocessore (<i>New architectures for microprocessors</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Potenza digitale (<i>Digital power</i>) ● Test analogico (<i>Analog test</i>) ● Elettromeccanici/Passivi/Connettori (<i>Passives/Electromechanics/Connectors</i>) ● Smart grid ● Sensori di temperatura digitali (<i>Digital temperature sensors</i>) 	<p>Embedded World 2012, 28/2-1/03 - Norimberga (D) CeBIT 2012, 06-10/03 - Hannover (D) Date 2012, 12-16/03 - Dresda (D) Smart Systems Integration 2012, 21-22/03 - Zurigo (CH) MC4 - Motion Control for, marzo Bologna (I) Laser World of Photonics, 20-22/03 - Shanghai (PRC)</p>
417 Aprile <i>April</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Semiconduttori di potenza (<i>Power semiconductors</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● IC di alimentazione (<i>Power supply ICs</i>) ● Tecnologie touchscreen (<i>Touchscreen technologies</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Collaudo RF/wireless (<i>RF/Wireless test tools</i>) ● IC analogici/mixed signal (<i>Analog/mixed signal ICs</i>) ● Sensori per self-driving car (<i>Self-driving car sensors</i>) ● Chip per network (<i>Network chips</i>) ● Elettronica di potenza (<i>Power electronics</i>) 	<p>Hannover Messe 2012, 23-27/04 - Hannover (D) Display International 2012, 11-13/04 - Tokyo (J)</p>
418 Maggio <i>May</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Soluzioni programmabili (<i>Programmable solutions</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Illuminazione a stato solido (<i>Solid state lighting</i>) ● Tecnologie per la conservazione dell'energia (<i>Energy storage technologies</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● ASIC/ASSP (AS/ICs/ASSPs) ● Integrità dei segnali (<i>Signal integrity</i>) ● Nanotecnologie (<i>Nanotechnologies</i>) ● Analizzatori di spettro/rete (<i>Network spectrum analyzers</i>) ● Standard wireless (<i>Wireless standards</i>) ● Optoelettronica e fotonica (<i>Optoelectronics & photonics</i>) 	<p>Embedded Systems Conference, maggio - San Jose (CA-USA) SMT/Hybrid/Packaging 2012, 08-10/05 - Norimberga (D) PCIM Europe 2012, 08-10/05 - Norimberga (D) SPS Italia, 22-24/05 - Parma (I)</p>
419 Giugno <i>June</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● DSP (<i>Directory</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Soluzioni medicali portatili (<i>Portable medicals</i>) ● Elettronica & auto elettrica (<i>Electronics and electric cars</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Interconnessioni seriali (<i>Serial interconnections</i>) ● Energie alternative (<i>Alternative energies</i>) ● Tool per la progettazione con FPGA (<i>FPGA development tools</i>) ● Elettronica 3D (<i>3D electronics</i>) ● MEMS e sensori avanzati (<i>MEMS and advanced sensors</i>) 	<p>Vision for Manufacturing, giugno - (I)</p>
420 Luglio/agosto <i>July/August</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Nuove tecnologie (<i>New technologies</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Standard wireless (<i>Wireless standards</i>) ● Elettronica indossabile (<i>Wearable electronics</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Simulazione EM per EMC (<i>Electromagnetic simulation tools</i>) ● Strumentazione T&M (<i>T&M instrumentation</i>) ● Chip grafici (<i>Graphics ICs</i>) ● IC di gestione della potenza (<i>Power managements ICs</i>) ● La casa digitale (<i>Digital home</i>) 	<p>NI-Week 2012, agosto - Austin (Texas-USA)</p>
421 Settembre <i>September</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Strumentazione per test wireless (<i>Wireless test instruments</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Touchscreen ● Tecniche e algoritmi di cifratura (<i>Cypher methodologies and algorithms</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Elettromeccanici/passivi/connettori (<i>Electromechanics/Passives/Connectors</i>) ● IC di conversione (<i>Conversion ICs</i>) ● Logiche programmabili (PLDs) ● Terre rare (<i>Rare earth</i>) ● Home healthcare (<i>Home healthcare</i>) 	<p>C&C - Control & Communication, settembre - (I)</p>
422 Ottobre <i>October</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Convertitori c.c./c.c. (<i>d.c./d.c. converters</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● IP/SoCs ● IC per elaborazioni video/immagini (<i>Image and video processing</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sicurezza dei dati (<i>Data security</i>) ● IC analogici/Mixed signal (<i>Analog/Mixed signal ICs</i>) ● Strumentazione T&M (<i>T&M instrumentation</i>) ● MCU low-power (<i>Low power MCUs</i>) ● Chip RF (<i>RF chips</i>) 	<p>Same 2012 - ottobre</p>
423 Novembre/ dicembre <i>November/ December</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● MCU (<i>Directory</i>) <p>Speciale Uomini & Imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Optical Computing ● Infotainment a bordo veicolo (<i>In-vehicle infotainment</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Strumentazione T&M (<i>T&M instruments</i>) ● IC analogici/mixed signal (<i>Analog/mixed signal ICs</i>) ● Tecnologie di illuminazione (<i>Lighting technologies</i>) ● Standard wireless (<i>Wireless standards</i>) ● Tool di progettazione on-line (<i>On-line design tools</i>) 	<p>Electronica 2012, 13-16/11 - Monaco (D) SPS/IPC/Drives 2012, 27-29/11 - Norimberga (D) Focus Embedded, novembre - (I)</p>

Formati pubblicitari / Advertising formats

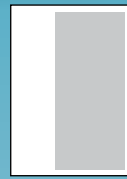
AUTOMAZIONE OGGI • FIELDBUS & NETWORKS • ELETTRONICA OGGI • EMBEDDED •
 RMO - Rivista di Meccanica Oggi • Energie & Ambiente Oggi • PROGETTARE • FLUIDOTECNICA



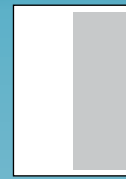
PAGINA INTERA
 FULL PAGE
 210 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 190 X 260 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



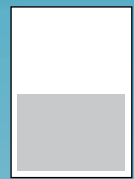
DOPPIA PAGINA UNI
 DOUBLE PAGE
 SPREAD UNI
 420 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED



2/3 PAG. VERTICALE
 IN GABBIA
 2/3 PAGE VERTICAL
 (TYPE AREA)
 118 X 260 mm



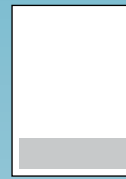
1/2 PAG. VERTICALE
 HALF PAGE VERTICAL
 100 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 90 X 260 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



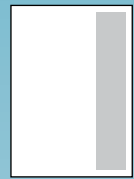
1/2 PAG. ORIZZONTALE
 HALF PAGE HORIZONTAL
 210 X 140 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 190 X 130 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



1/4 PAG. ORIZZONTALE
 1/4 PAGE HORIZONTAL
 100 X 130 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 90 X 120 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



1/3 PAG. ORIZZONTALE
 1/3 PAGE HORIZONTAL
 210 X 105 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 181 X 90 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



1/3 PAG. VERTICALE
 1/3 PAGE VERTICAL
 80 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED
 56 X 260 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 148 X 210 mm
 SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 148 X 210 mm
 BLEED



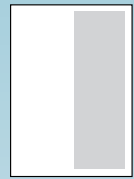
1/2 PAG. ORIZZONTALE
 HALF PAGE HORIZONTAL
 180 X 125 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



DOPPIA PAGINA UNI
 DOUBLE PAGE SPREAD UNI
 420 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED

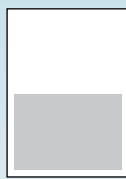


PAGINA INTERA
 FULL PAGE
 210 X 297 mm
 (VIVO + REFILI) / BLEED



1/2 PAG. VERTICALE
 HALF PAGE VERTICAL
 90 X 240 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA

EO NEWS



1/2 PAGINA ORIZZONTALE
 1/2 PAGE HORIZONTAL
 265 X 154 mm
 + REFILI / BLEED
 235 X 137 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA



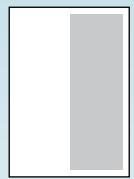
DOPPIA KING SIZE
 DOUBLE KING SIZE PAGE
 530 X 310 mm + REFILI / BLEED
 500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE
 AREA



KING SIZE / KING SIZE
 265 X 310 mm
 + REFILI / BLEED
 245 X 290 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA

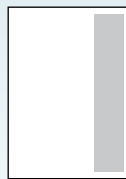


UNI / UNI PAGE
 203 X 230 mm
 + REFILI / BLEED
 187 X 218 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA

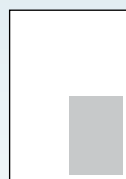


1/2 PAGINA VERTICALE
 1/2 PAGE VERTICAL
 132 X 310 mm
 + REFILI / BLEED
 115 X 262 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA

DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
 PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA



1/3 PAG. VERTICALE
 1/3 PAGE VERTICAL
 80 X 280 mm
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



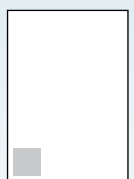
1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
 133 X 155 mm
 + REFILI / BLEED
 115 X 137 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA



JUNIOR / JUNIOR
 154 X 201 mm
 + REFILI / BLEED
 140 X 183 mm
 IN GABBIA / TYPE AREA



MANCHETTE 1° COPERTINA
 79 X 61 mm
MANCHETTE NEWS
 91 X 61 mm



SPAZIO MERCATO
 78 X 78 mm